

レーザー協会 第195回研究会

「エレクトロニクス分野のレーザー利用」

開催日時: 令和5年2月22日(水)13:30~17:00

会場: 千葉工業大学 津田沼キャンパス 6号館1階614教室
(千葉県習志野市津田沼2-17-1、最寄り駅: JR総武線 津田沼駅)

開催形式: ハイブリッド形式(対面/オンライン形式複合)

※現在の新型コロナ感染状況を鑑み、ハイブリッドに致しました。

研究会主旨: 「エレクトロニクス分野のレーザー利用」と題し、計4件の講演を行います。

エレクトロニクスは人間生活と密接に関わっており、電気自動車の普及など

今後の成長は計り知れません。この分野では銅のレーザー加工(除去や溶接)が進んでいます。そこで銅加工に関連した発振器や溶接技術、基板加工も含めて第一線でご活躍の企業から最新技術をご紹介します。万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようお願い申し上げます。



13:30~13:35 **開会挨拶**

レーザー協会会長 池野 順一

13:35~14:20 **講演1**

「高出力青色半導体レーザーの適用事例」

レーザーライン株式会社 木野本 亮氏

14:20~15:05 **講演2**

「Blue-IR ハイブリッドレーザー BRACE® - 進化する銅レーザー溶接技術」

古河電気工業株式会社 安岡 知道氏

15:05~15:20 ————— 休憩 —————

15:20~16:05 **講演3**

「LPKF プリント基板加工用レーザーについて」(資料がご入り用の方は、会場にてお申し出下さい)

LPKF Laser & Electronics 株式会社 伊藤 諭美氏

16:05~16:50 **講演4**

「レーザーによるプリント配線板加工技術」

ビアメカニクス株式会社 西山 宏美氏

16:50~17:00 **閉会挨拶**

レーザー協会副会長 徳永 剛

【参加費】 会員: 無料 非会員: 4,000円(2月20日までに協会口座にお振込みください)

【申込先】 レーザー協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申込みフォームよりお申し込み下さい。

・参加申込〆切: 令和5年2月15日(水) 17時

【問合せ先】 レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp